

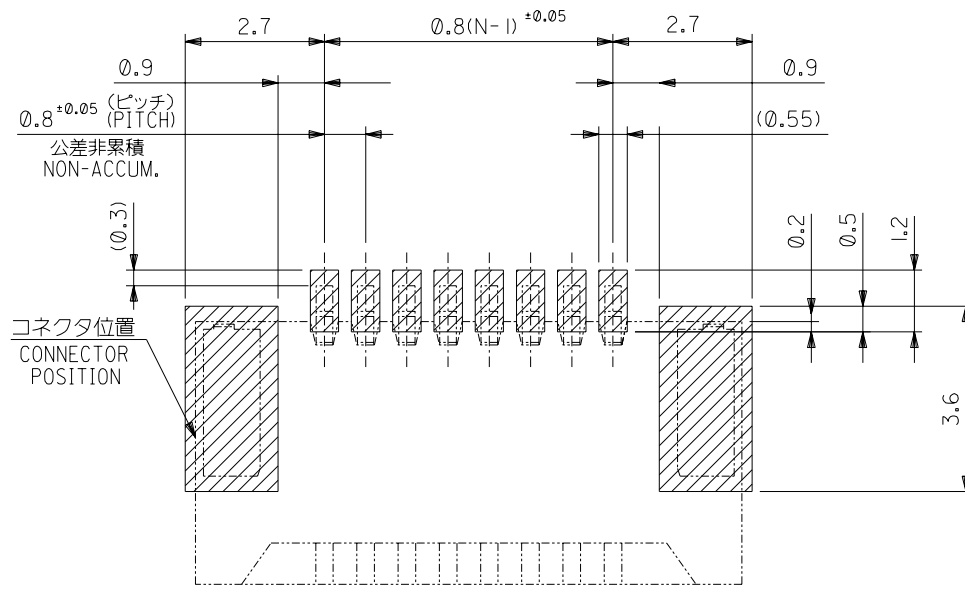
注記 NOTES

- 使用材料 MATERIAL
 - ハウジング: PPS, UL94V-0 HOUSING: PPS, UL94V-0
 - ターミナル: リン青銅 (t=0.32) TERMINAL: PHOSPHOR BRONZE
 - メッキ: 錫ビスマスメッキ PLATING: TIN-BISMUTH PLATED
 - 金具: リン青銅 (t=0.2) FITTING NAIL: PHOSPHOR BRONZE
 - メッキ: 錫メッキ PLATING: TIN PLATED
- △ ソルダテール半田付け面のズレ量及び、金具半田付け面のズレ量は、基準面 G に対し上方向に 0.05MAX. 下方向に 0.15MAX. とする。 MISALIGNMENT OF SOLDER TAILS AND FITTING NAILS FROM G UPPER DIRECTION: 0.05MAX. LOWER DIRECTION: 0.15MAX.
- △ ハウジングの C から隣接するターミナルの C 迄の位置を示す。 SHOW POSITION FROM C OF HOUSING TO C OF ADJACENT TERMINALS.
- △ 4~10 極に適用。 APPLICABLE TO 4-10 CIRCUIT.

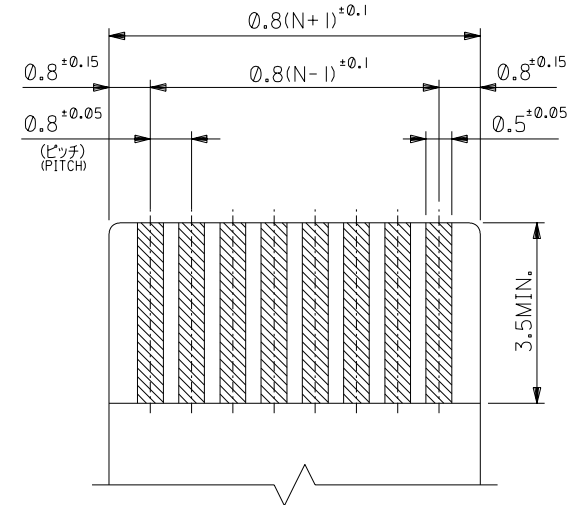
5. 本製品は 52557-**-10 の鉛フリー品である。
THIS PRODUCT IS LEAD FREE OF 52557-**-10.

0.4	20.2	16.82	15.2	52557-2019	20	
0.4	18.6	15.22	13.6	-1819	18	
0.4	17.0	13.62	12.0	-1619	16	
0.8	16.2	12.82	11.2	-1519	15	
0.4	15.4	12.02	10.4	-1419	14	
0.8	14.6	11.22	9.6	-1319	13	
0.4	13.8	10.42	8.8	-1219	12	
0.8	13.0	9.62	8.0	-1119	11	
0.4	12.2	8.82	7.2	-1019	10	
0.8	11.4	8.02	6.4	-0919	9	
0.4	10.6	7.22	5.6	-0819	8	
0.8	9.8	6.42	4.8	-0719	7	
0.4	9.0	5.62	4.0	-0619	6	
0.8	8.2	4.82	3.2	-0519	5	
52557-**-19	0.4	7.4	4.02	2.4	52557-0419	4
MODEL NO.	D	C	B	A	MATERIAL NO.	極数 CKT.

角度 ANGLE	±3°	材料 MATERIAL	注記参照 SEE NOTES	MATERIAL NO. 極数 CKT.
30 以上 OVER	+0.3	仕上げ FINISH	—	
10 以上 OVER 30 未満 UNDER	+0.25	適用電線範囲 WIRE RANGE	—	REVISE ONLY ON CAD SYSTEM
10 未満 UNDER	+0.2	被覆外径 INS. RANGE	—	TITLE 名称
一般公差 GENERAL TOLERANCES	記号 LTR	新規作成 (J2004-3096) RELEASED	04/03/15	0.8 FFC CONN. NON ZIF SMT
		変更内容 REVISION RECORD	DR. M.SASAO	-LEAD FREE-
		日付 DATE	04/03/15	DWG. NO. (SHEET 1 OF 2) REV
		尺度 SCALE	—	SD-52557-009 0



参考基板レイアウト (マウント面)
P.C.B. PATTERN LAYOUT (REF.) (MOUNT AREA)



適合FFC/FPC推奨寸法
RECOMMENDED APPLICABLE
FFC/FPC LAYOUT
(仕上がり厚さ: 0.3 ± 0.05)
(THICKNESS: 0.3 ± 0.05)

DIMENSIONS IN METRIC DO NOT SCALE DRAWING

MODEL NO. 52557-**-19

材料 MATERIAL		注記参照 SEE NOTES		molex MOLEX-JAPAN CO.,LTD. 日本モレックス株式会社	
仕上げ FINISH		---		REVISE ONLY ON CAD SYSTEM	
適用電線範囲 WIRE RANGE		---		TITLE 名称	
被覆外径 INS. RANGE		---		0.8 FFC CONN. NON ZIF SMT -LEAD FREE-	
DRAWN BY '04/03/15 H.KAWABATA		CHK'D BY '04/03/15 K.TOJO		DWG. NO. (SHEET 2 OF 2) REV	
APP'D BY '04/03/15 M.SASAO		尺 度 SCALE		SD-52557-009 0	
角度 ANGLE	±3°	記号 LTR	変更内容 REVISION RECORD	DR. CHK.	日付 DATE
30以上 OVER	+0.3	0	新規作成 (J2004-3096) RELEASED	日付	'04/03/15
10以上 OVER 30未滿 UNDER	+0.25				
未滿 UNDER	+0.2				
一般公差 GENERAL TOLERANCES					

:MM DIMENSIONS IN METRIC DO NOT SCALE DRAWING

ENG. NO. SD-52557-010

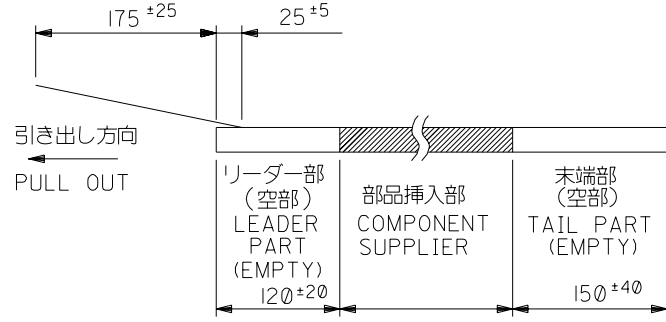
EDP NO.

注記 NOTES

1. 梱包数量：1000個/リール NUMBER OF CONNECTORS:1000PCS/REEL

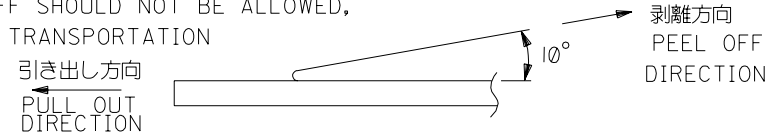
2. リードテープ長さ LEAD TAPE LENGTH

トップテープ TOP TAPE トップテープ TOP TAPE
 リーダー部 LEADER PART 未接着部 NON-BONDED PART



3. トップテープの剥離強度：(剥離方向は下図参照)
 0.1~1.3N {10~130gf} 尚、本規格値は、出荷時に適用。
 (但し、輸送時に剥離が発生しない事。)

PEELING OFF FORCE OF TOP TAPE
 0.1~1.3N {10~130gf} (PEELING DIRECTION AS SHOWN IN FOLLOWING FIG.)
 THIS REQUIREMENT SHOULD BE APPLIED AT SHIPMENT
 PEEL OFF SHOULD NOT BE ALLOWED,
 DURING TRANSPORTATION



4. 材料 キャリアテープ：ポリプロピレン (PP)
 トップテープ：PET, PE, PEF
 リール：ポリスチレン (PS) <リサイクル材を含む>
 MATERIAL CARRIER TAPE:POLYPROPYLENE
 TOP TAPE:PET,PE,PEF
 REEL:POLYSTYREN(PS)
 <RECYCLE MATERIAL CONTAINED>

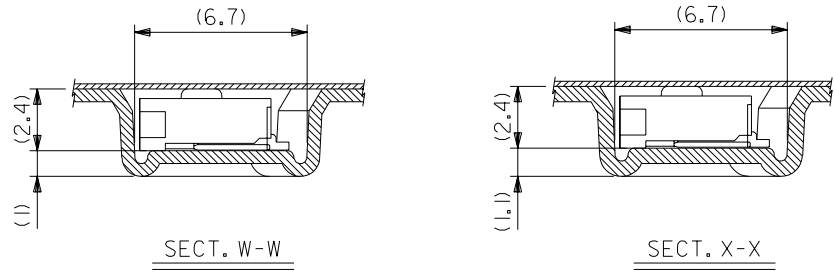
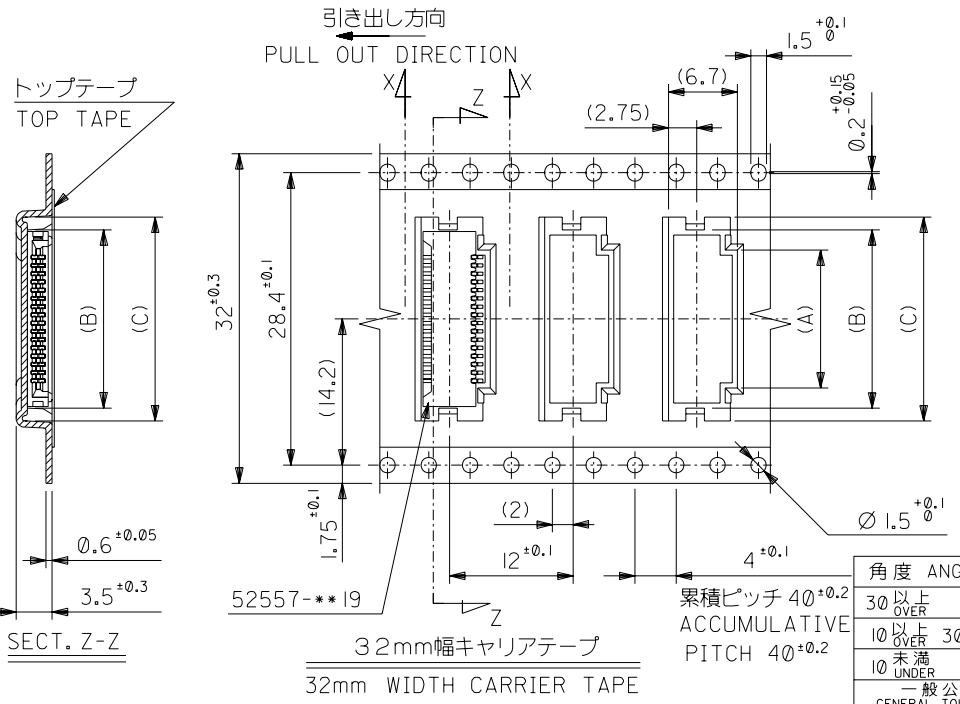
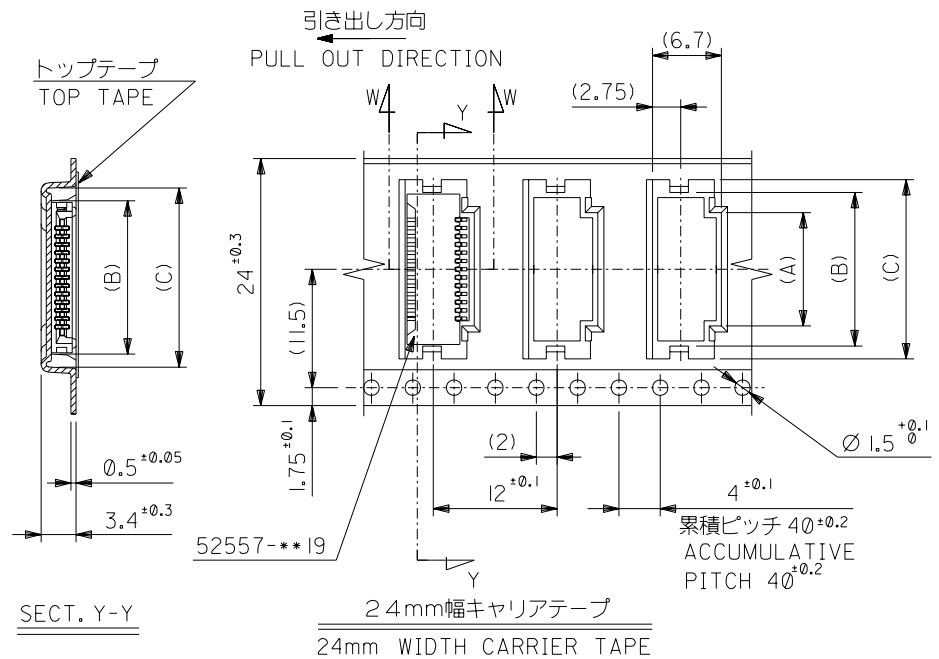
5. 本製品は52557-**-90の鉛フリー品である。
 THIS PRODUCT IS LEAD FREE OF 52557-**-90.

52557-**-70
 MODEL NO.

		材料 MATERIAL		注記参照 SEE NOTES		molex MOLEX-JAPAN CO.,LTD. 日本モレックス株式会社	
		仕上げ FINISH		—		EDP. NO. —	
		適用電線範囲 WIRE RANGE		—		ENG. NO. (SHEET 1 OF 3) REV	
		被覆外径 INS. RANGE		—		SD-52557-010 0	
角度 ANGLE		±3°	新規作成 RELEASED (J2004-3096)		04/03/15	TITLE 名称	
30以上 OVER	±0.5	記号 TR		DR. H.KAWABATA	CHK'D BY 04/03/15 K.TOJO	0.8 FFC Conn NON ZIF	
10以上 OVER 30未満 UNDER	±0.25	変更内容 REVISION RECORD		DR. M.SASAO	APP'D BY 04/03/15	SMT Embstp pkg	
10未満 UNDER	±0.2	一般公差 GENERAL TOLERANCES		REVISE ONLY ON CAD SYSTEM		-LEAD FREE-	

ENC. NO. SD-52557-010
EDP NO.

ALL DIMENSIONS IN METRIC DO NOT SCALE DRAWING



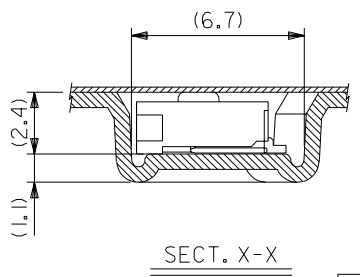
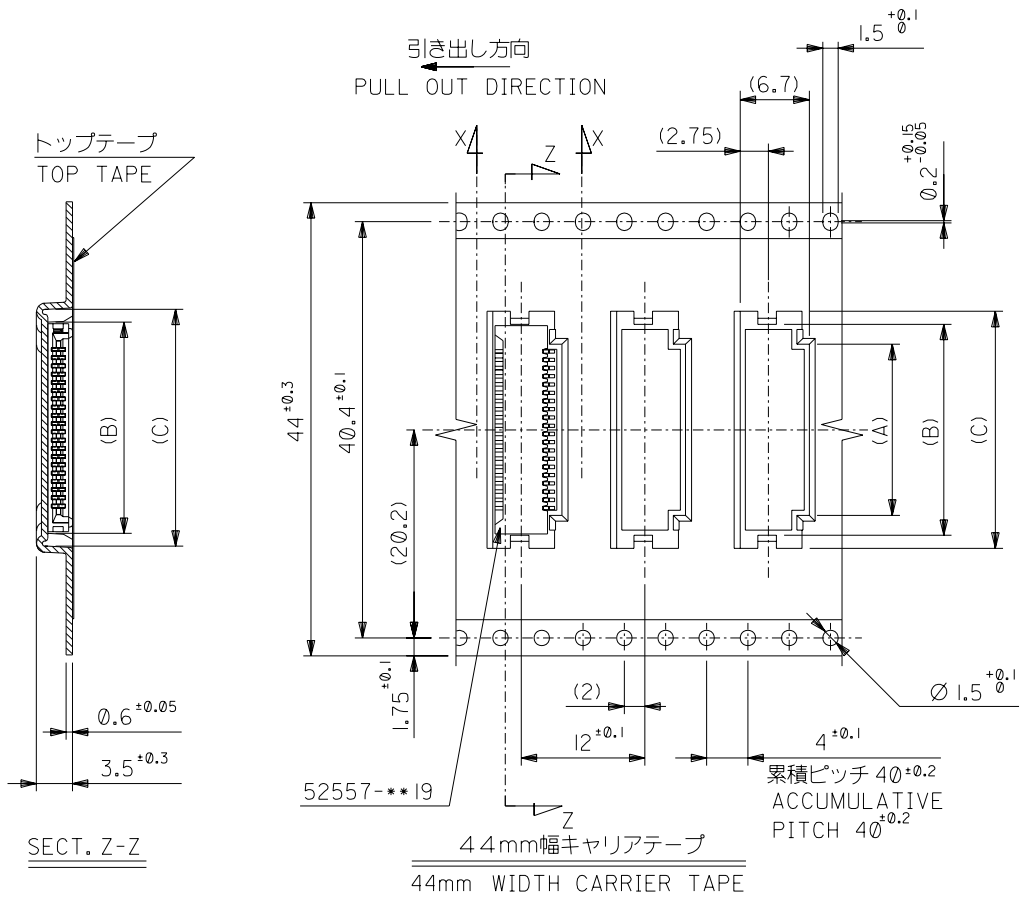
MODEL NO.	CARRIER TAPE WIDTH	E	D	(C)	(B)	(A)	MATERIAL NO.	極数 CIRCUIT
52557-**-70	32	37.4	33.4	21.4	18.9	15.0	52557-1870	18
				19.8	17.3	13.4	-1670	16
				19.0	16.5	12.6	-1570	15
52557-**-19	24	29.4	25.4	18.2	15.7	11.8	-1470	14
				17.4	14.9	11.0	-1370	13
				16.6	14.1	10.2	-1270	12
				15.8	13.3	9.4	-1170	11
				15.0	12.5	8.6	-1070	10
				14.2	11.7	7.8	-0970	9
				13.4	10.9	7.0	-0870	8
				12.6	10.1	6.2	-0770	7
				11.8	9.3	5.4	-0670	6
				11.0	8.5	4.6	-0570	5
				10.2	7.7	3.8	52557-0470	4

角度 ANGLE	±3°
30°以上 OVER	+0.5
10°以上 OVER 30°未滿 UNDER	+0.25
10°未滿 UNDER	+0.2
一般公差 GENERAL TOLERANCES	

記号	新規作成 (J2004-3096)	日付	04/03/15
変更内容 REVISION RECORD		DR. CHK.	
REVISE ONLY ON CAD SYSTEM			

材料 MATERIAL	SHEET 1 OF 3 参照 REFER TO SHEET 1 OF 3	
仕上げ FINISH		
適用電線範囲 WIRE RANGE	—	
被覆外径 INS. RANGE	—	
DRAWN BY	H.KAWABATA	CHK'D BY 04/03/15 K.TOJO
APP'D BY	M.SASAO	尺度 SCALE —

MATERIAL NO.		MATERIAL NO.	
EDP. NO.		—	
ENG. NO. (SHEET 2 OF 3)		REV	
SD-52557-010		0	
TITLE 名称 0.8 FFC Conn NON ZIF SMT Embstp pkg -LEAD FREE-			



52557-**70	44	49.4	45.4	23.0	20.5	16.6	52557-2070	20
MODEL NO.	キャリアテープ幅 CARRIER TAPE WIDTH	E	D	(C)	(B)	(A)	MATERIAL NO.	極数 CIRCUIT
材料 MATERIAL SHEET 1 OF 3 参照 REFER TO SHEET 1 OF 3							molex MOLEX-JAPAN CO.,LTD. 日本モレックス株式会社	
仕上げ FINISH							EDP. NO. //	
適用電線範囲 WIRE RANGE //							ENG. NO. (SHEET 3 OF 3) REV	
被覆外径 INS. RANGE //							SD-52557-010 0	
角度 ANGLE	±3°						DRAWN BY '04/03/15 H.KAWABATA	
30 以上 OVER	+0.5						CHK'D BY '04/03/15 K.TOJO	
10 以上 OVER	30 未満 UNDER	0	新規作成 (J2004-3096) RELEASED				APP'D BY '04/03/15 M.SASAO	
10 未満 UNDER	+0.2	記号 LTR	変更内容 REVISION RECORD	DR. CHK.	日付 DATE	TITLE 名称 0.8 FFC Conn NON ZIF SMT Embstp pkg -LEAD FREE-		
一般公差 GENERAL TOLERANCES		REVISE ONLY ON CAD SYSTEM					SCALE //	

THIS DRAWING CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO MOLEX(JAPAN) AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION
本図面は日本モレックス(株)の所有する情報を含むもので 当社の許可なく複製を禁止する。